

両端支持構造による高い剛性

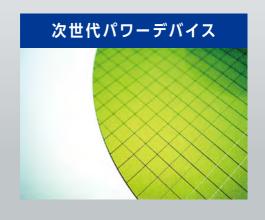
超音波アシストが生む高品質切断

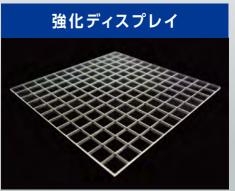
超音波カッティング装置 CSX501



ブレードダイシングの限界を超え、次世代材料切断へ挑戦する

難削材 VS 超音波アシスト切断





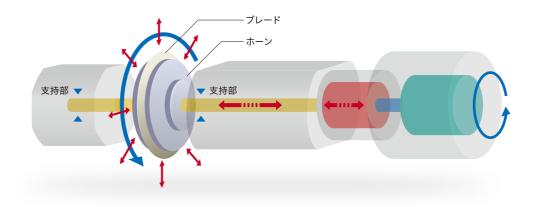


超音波カッティングとは

超音波カッティング装置 **CSX501**

Ultrasonic Cutting System

回転砥石による切断 + 超音波アシストにより 切断負荷とブレード摩耗の低減を実現



TAKADA独自の両端支持構造により、 超音波振動を効率的にブレードへ伝達し、高精度な高速切断を実現

装置概要

生産性の向上

- ▶搬送ラインを最適化、搬送タクトを30%短縮(当社比)
- ▶ブレード破損検知機能を改善し、切断動作時間を短縮

切断バリ除去機能

▶切断対象に残っているバリを除去 することが可能

※ワークによって効果が得られない 場合があります



遠隔装置状態 監視機能

▶装置状態を遠隔監視(オプション)を することで不測のトラブル時に原因 究明の手助けをし、平均復旧時間を 短縮



省フットプリントの実現

▶装置横幅を20%縮小(当社比)

最大ワークサイズ	Ф200mm
最大フレーム	6,8インチリング
X軸	切断可能範囲 220mm 最大切断速度 500mm/s
Y軸	切削可能範囲 220mm 最高速度 500mm/s
Z軸	ストローク 129.5mm
装置寸法	$1,200$ mm $^{(W)} \times 1,320$ mm $^{(D)} \times 1,850$ mm $^{(H)}$
装置重量	約2,500kg

TAKADA

問い合わせ先 株式会社 高田工業所 装置事業部 〒806-8567 福岡県北九州市八幡西区築地町2-1 TEL 093-632-2600

https://www.takada.co.jp/jigyo/usw/



切断材料 ▶ SiC、PZT、AlN、水晶、石英、樹脂など各種基板材料のダイシング

無償切断評価を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。